

HA8000シリーズ
ハードウェア アーキテクチャーガイド
(2009年11月～出荷モデル)
(2009年6月～出荷モデル)

◆本アーキテクチャーガイドの注意事項について

- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断りします。
- ・本書の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、ご連絡頂けますようお願いいたします。
- ・本書の内容については ハードウェアの基本ブロック図の記載のみです。

◆登録商標・著作権

Microsoft®, Windows®は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。

Pentium ,Xeon,Celeron は、Intel Corporation.の商標または登録商標です。

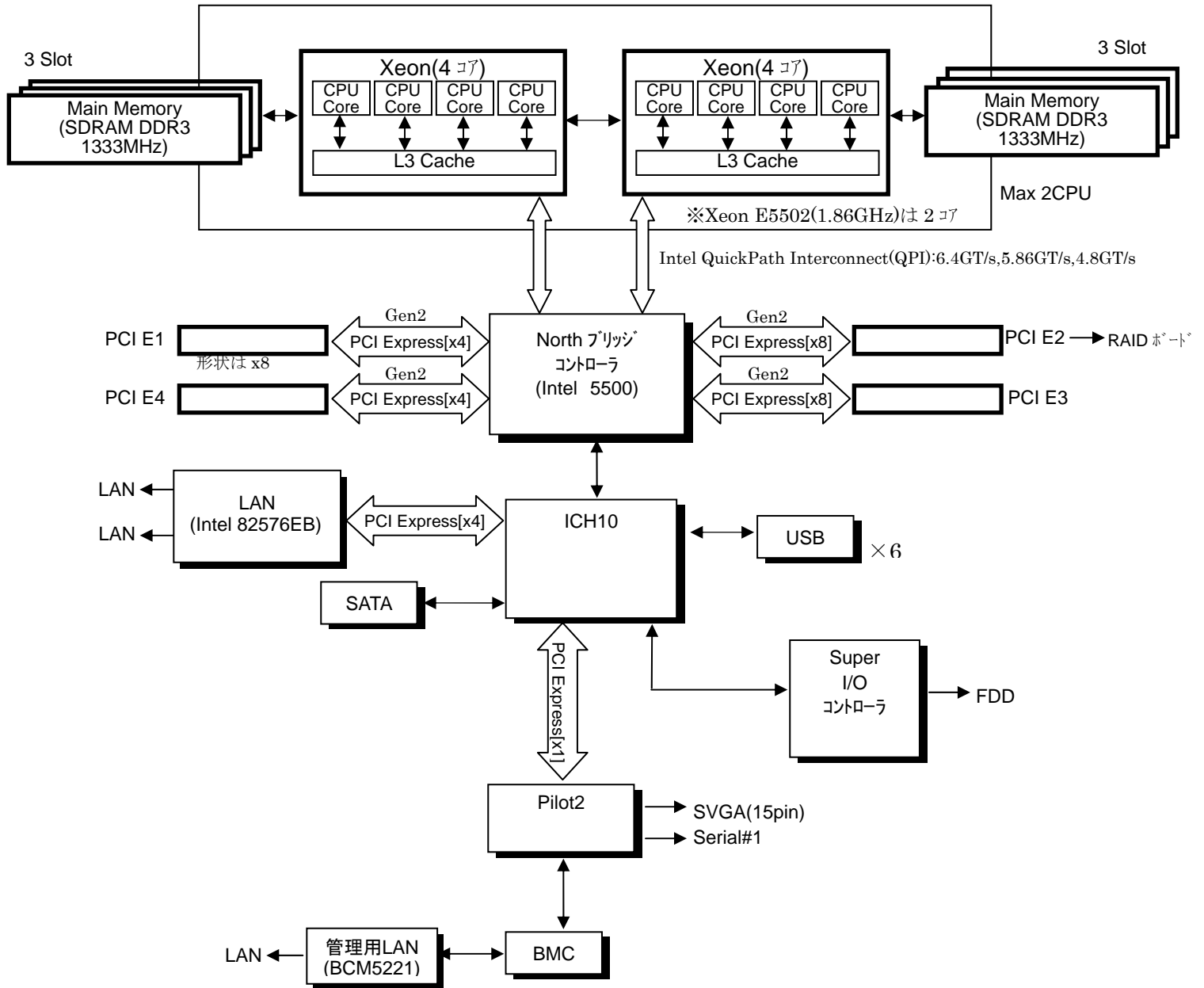
登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

HA8000/TS20 アーキテクチャー

HA8000/TS20 AJ,BJ,EJ,FJ には以下の特徴があります。

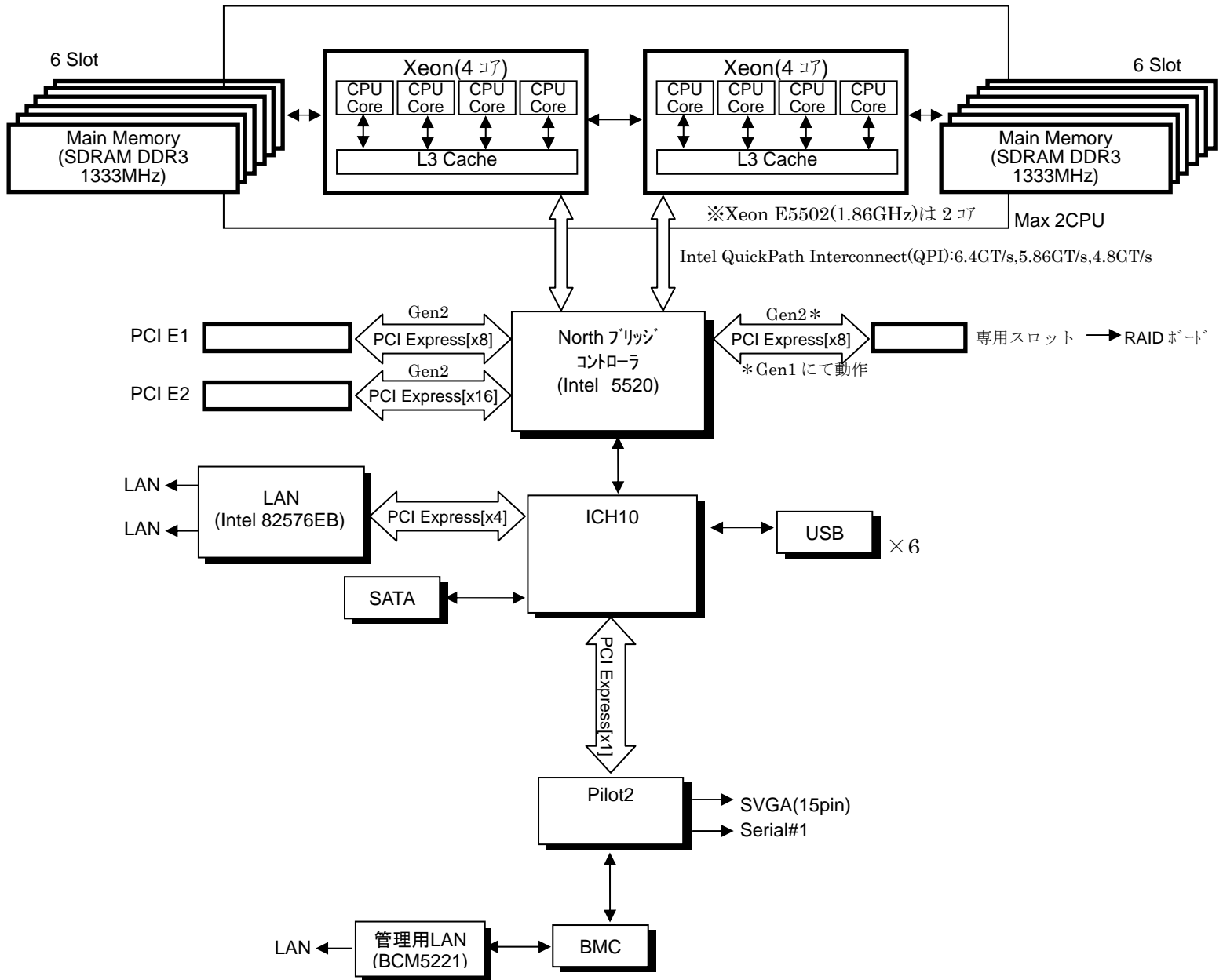
- ・インテル社製 5500 チップセット採用による 2 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ X5570(2.93GHz)/E5540(2.53GHz)/E5520(2.26GHz)/E5502(1.86GHz) を採用
- ・DDR3 1333 Registered DIMM の採用により高速な I/O を実現。x4/x8 SDDC、メモリーミラーリング対応、最大 48GB(24GB/CPU)搭載可能



HA8000/RS210 アーキテクチャー

HA8000/RS210 AJ,BJ,HJ,FJ,JJ には以下の特徴があります。

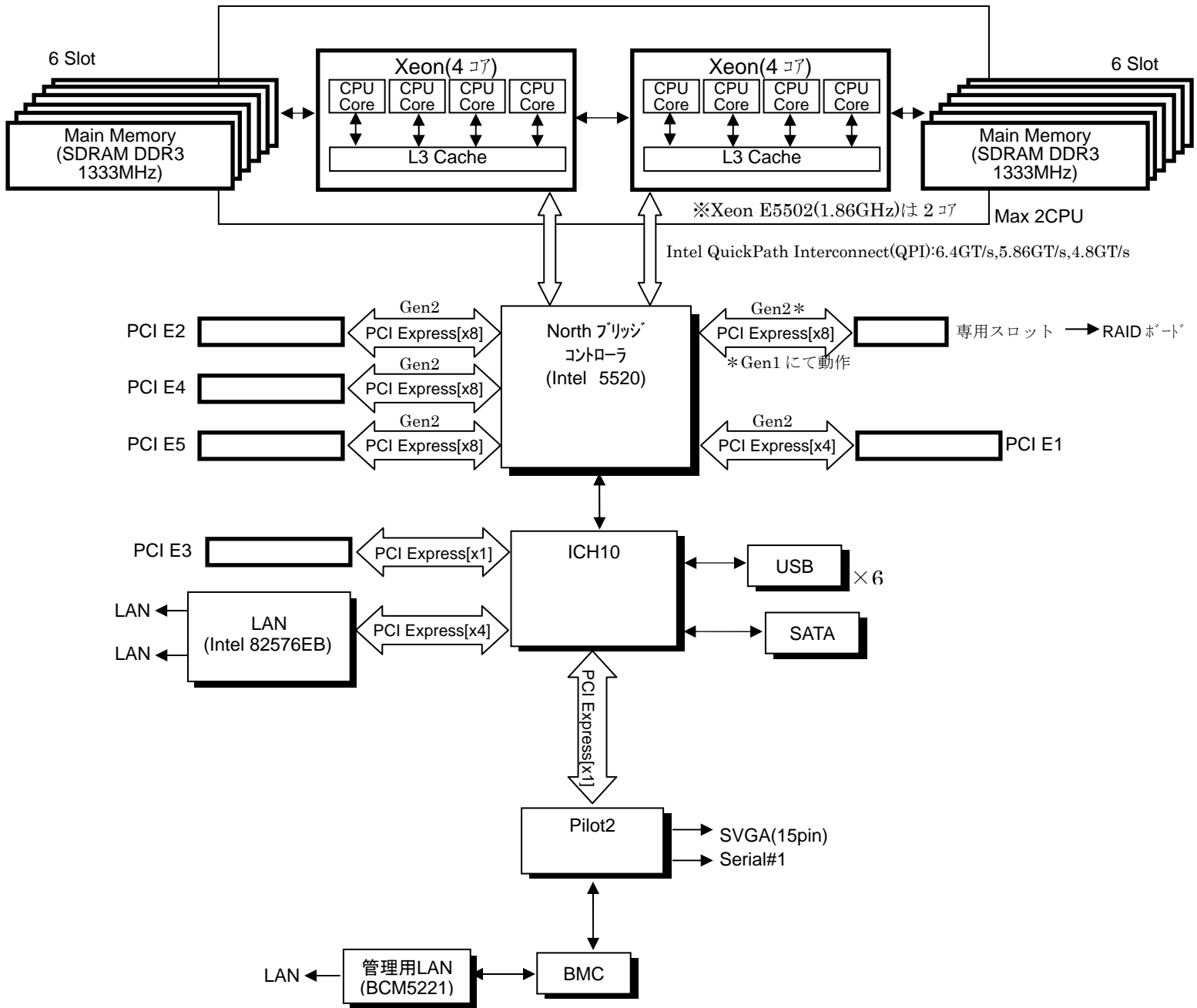
- ・インテル社製 5520 チップセット採用による 2 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ X5570(2.93GHz)/E5540(2.53GHz)/E5520(2.26GHz)/E5502(1.86GHz) を採用
- ・DDR3 1333 Registered DIMM の採用により高速な I/O を実現。x4/x8 SDDC、メモリーミラーリング対応、最大 96GB(48GB/CPU)搭載可能



HA8000/RS220 アーキテクチャー

HA8000/RS220 AJ,BJ,DJ,HJ,FJ,JJ には以下の特徴があります。

- ・インテル社製 5520 チップセット採用による 2 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ X5570(2.93GHz)/E5540(2.53GHz)/E5520(2.26GHz)/E5502(1.86GHz) を採用
- ・DDR3 1333 Registered DIMM の採用により高速な I/O を実現。x4/x8 SDDC、メモリーミラーリング対応、最大 96GB(48GB/CPU)搭載可能



HA8000/RS440 アーキテクチャー

HA8000/RS440 AJ,BJ には以下の特徴があります。

- ・インテル社製 7300 チップセット採用による 4 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ X7460(2.66GHz)/E7450(2.40GHz)/E7420(2.13GHz)/E7220(2.93GHz) の採用。(100V は E7450/E7420/E7220 のみ)
- ・DDR2 667 FB-DIMM の採用により高速な I/O を実現。x4/x8 SDDC、オンラインスペアメモリー、メモリーミラーリング対応。最大 256GB 搭載可能。(BJ モデルはメモリーミラー未サポート、最大 128GB)

